

第47回レーザー協会セミナー

次世代産業ニーズに応じて進化する
高機能レーザー加工技術

～ 発振器・ビームシェイプ・加工機と最新加工事例 ～

主催:レーザー協会

協賛:精密工学会, 砥粒加工学会, 日本機械学会, レーザー学会, レーザ加工学会,
光産業技術振興協会, 日本オプトメカトロニクス協会, 日本溶接協会, 日刊工業新聞社,
イーエクス プレス社, オプトロニクス社, 新報, 産報出版

【日時】: 2023年11月2日(木) 10:00～16:30

【会場】: 東京都立産業貿易センター 浜松町館(4階第2会議室)

〒105-7501 東京都港区海岸 1-7-1 東京ポートシティ竹芝

アクセス <https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/>

10:00～10:05	開会挨拶	レーザー協会会長 池野 順一
10:05～10:50	講演1 「切断用レーザー加工機の最新技術とその加工事例」	三菱電機(株) 荻田 平 氏
10:50～11:35	講演2 「カーボンニュートラルに貢献する Mazak のレーザー加工技術」	ヤマザキマザック(株) 大内 誠悟 氏
11:35～12:30	休憩	
12:30～13:15	講演3 「Blue-IR ハイブリッドレーザーによる e-Mobility 化に向けたレーザー加工技術」	古河電気工業(株) 橋本 博 氏
13:15～14:00	講演4 「高出力グリーンレーザーを用いた EV 用銅部品への適用事例」	トルンプ(株) 塩見 亮祐 氏
14:00～14:45	講演5 「ビームシェーピング技術」	(株)プロフィット 奈良 拓治氏
14:45～15:00	休憩	
15:00～15:45	講演6 「焦点可変デフォーマブルミラーの高出力レーザー加工への応用」	オーテックス(株) 辻川 晋 氏
15:45～16:30	講演7 「フェムト秒ファイバーレーザーによる非熱微細加工と 2光子吸収を利用した3Dプリンターへの応用」	(株)オプトサイエンス 脇田 和則 氏
16:30	閉会挨拶	レーザー協会副会長

参加費: 会員:10,000円, 協賛会員:20,000円, 非会員:25,000円, 学生:4,000円(テキスト無し)

申込締切日: **2023年10月19日(木)** (※協賛会員は所属団体を明記ください)申込方法: レーザー協会ウェブページ(<http://jslt.jp/>) 申し込みフォームからお申し込みください。問合せ先: レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp